

## Sigmattech

### 非接觸式晶片厚度/彎曲度/翹曲度/平坦度量測系統

Sigmattech 公司專注於各式晶圓的量測上，舉凡晶圓的厚度(Thickness)、彎曲度(Bowl)、翹曲度(Warp)、平坦度(Flatness)等皆可量測。Sigmattech 專有的 2 種量測技術 APBP(Auto-positioning Back pressure)及白光 (White Light Chromator) 反射的技術可搭配在機台上使用，在各式半導體晶圓(Si)、特殊晶圓(Sapphire、Quartz...)、III-V(GaAs、GaP...)、玻璃材料(Glass...)、SiC、SOI、Wafer on sawframe、凸塊晶圓(Bumped wafer)、太陽能晶片(mono/poly crystalline)...及軟或硬材料上，適用範圍廣泛。

#### 兩種主要技術：

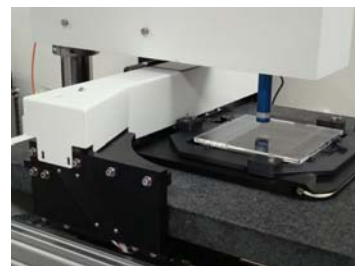
- A. APBP(Auto-positioning Back pressure): 利用氣體反壓，偵測反壓氣壓的微小變化，轉換成位置量。
- B. 白光 (White Light Chromator) 反射: 同時入射多波長的白光，計算反射回來的單光波長，進而得到位置資訊。經計算上下量測頭位置後，可得到晶片的厚度。

#### 量測參數：

- A. 晶圓厚度、彎曲度、翹曲度及平坦度。
- B. 超薄晶圓的厚度、彎曲度及翹曲度。
- C. 凸塊晶圓之凸塊高度、高度分佈、彎曲度及翹曲度。
- D. Sawframe 晶圓之各層厚度，總厚度、彎曲度及翹曲度。

#### 適用晶圓及材料：

- A. 矽(Silicon)晶圓：圓形、方形
- B. III-V 族晶圓：GaAs、Ge、InP、GaN...。
- C. 特殊晶圓：寶石 Sapphire、石英 Quartz、玻璃 Glass、SiC、SOI...
- D. Stacks of wafers。
- E. Wafer on Sawframe。
- F. Taped wafer and mounted wafer
- G. Solar Grade wafer



Contact name: Michael Tsai [michael@mast-tech.com.tw](mailto:michael@mast-tech.com.tw)

Tel: +886-3-5838122 Fax: +886-3-5835968

Cell: 0933063779